

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專訴字第44號

原告 致茂電子股份有限公司

法定代理人 黃欽明

訴訟代理人 張哲倫律師

陳佳菁律師

金若芸專利師

被告 惠特科技股份有限公司

法定代理人 徐秋田

訴訟代理人 廖鈺達專利師

劉沁瑋專利師

被告 徐秋田

共同

訴訟代理人 黃世瑋律師

輔佐人 詹偉鴻專利師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國111年11月29日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：伊為中華民國第I431291號「發光二極體量測裝置」發明專利(下稱系爭專利)之專利權人，專利權期間自民國103年3月21日至120年7月13日止。伊與被告惠特科技股份有限公司(下稱惠特公司)均從事機械設備、光學儀器製造及銷售等業務，伊於110年間在市場購得惠特公司所製造、販賣、為販賣要約或使用之「LFP 7004覆晶型LED晶粒/晶圓點

測機」(下稱系爭產品)，經搭配使用系爭產品不可或缺，且可由市場輕易取得之擴張環(含其上透明薄膜)組裝後進行測試分析，結果顯示系爭產品落入系爭專利請求項1至4、7之文義範圍，惠特公司明知並有預見或可避免侵害系爭專利致生損害之能力，仍未注意而使系爭產品流通於市場上，致系爭產品之使用者直接侵害系爭專利請求項1至4及7，為造意、幫助侵害系爭專利之共同行為人，因此獲有不法之利益，負排除侵害及損害賠償或返還不法利益之責任。又被告徐秋田(下稱徐秋田，與惠特公司合稱被告)自97年8月8日起擔任惠特公司之法定代理人兼總經理，參與系爭產品之製造、販賣、為販賣之要約或使用，應於其擔任惠特公司法定代理人期間，對伊負排除侵害及連帶給付之責。爰依專利法第96條第1項規定，請求被告排除侵害，及依同法第96條第2頁、第97條第1項第2款、第2項、民法第177條第2項、第179條、第184條第1項前段、第185條、公司法第23條規定，並以被告因侵害行為所得利益為據，請求被告連帶給付最低金額新臺幣(下同)1,000萬元，並聲明：(一)被告應連帶給付原告1,000萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。(二)被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品及其他侵害系爭專利之產品。(三)第1、2項聲明，願以現金或同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。

二、被告答辯：系爭產品不存在系爭專利請求項1之「間隔構件」、「軟性透明載體」等元件，縱搭配擴張環使用，亦無由「透明基板」、「間隔構件」、「軟性透明載體」等元件共同形成之密閉空間，未落入系爭專利請求項1之文義範圍，而系爭專利請求項2至4、7為請求項1之直接或間接附屬項，均具有請求項1之技術特徵，系爭產品自未落入系爭專利請求項2至4、7之文義範圍，未對系爭專利請求項1至4、7構成文義侵害。又依系爭專利說明書「先前技術」之記載及「圖一A」、「圖一B」，已揭露系爭專利之「透明基板、間

01 隔構件、軟性透明載體、間隔構件及透明基板之間形成一密
02 閉空間、真空產生器連接至該密閉空間並用以對該密閉空間
03 抽氣、軟性透明載體部分平貼於一面上以形成一用以承載該
04 覆晶式發光二極體之檢測區」等重要元件及各元件間之作動
05 結合關係，對於系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，在
06 參酌上開先前技術內容之教示，有動機調整或簡單置換先前
07 技術內容以獲致系爭專利所請之技術內容，系爭專利請求項
08 1至4、7自不具進步性。系爭專利所載之先前技術與如附表
09 所示乙證1或乙證2或乙證6或乙證1、2或乙證1、2、3之組
10 合，亦足以證明系爭專利請求項1至4、7不具進步性。另乙
11 證1與系爭專利均係運用光學檢測方法，對待檢測對象進行
12 缺陷或光度檢測，且均使用可透光之基板或玻璃板作為承載
13 待檢測對象之基座、使用具有可撓性且透明之撓性膜、使用
14 相當於系爭專利「間隔構件」之「框架部」與撓性膜相接
15 合，及實質揭示系爭專利之「密閉空間」，僅未明確揭露系
16 爭專利「該軟性透明載體部分平貼於第一面上以形成一檢測
17 區，該檢測區係用以承載該覆晶式發光二極體」之技術特
18 徵，但乙證1之檢查對象及基板均為可透光構件，其檢查對
19 象係下側面平貼於基板上，上側面(第一面)可供與軟性透明
20 載體平貼，其目的、功能及作用與系爭專利相同，均使用真
21 空吸附或負壓吸附手段以達到「穩定平整待處理物、提升處
22 理效果」之目的，故乙證1足以證明系爭專利請求項1、2不
23 具進步性。乙證1與乙證2或乙證2、3之組合，亦足以證明系
24 爭專利請求項1、2不具進步性。再者，系爭專利所載之先前
25 技術已揭露系爭專利請求項1至4、7之技術特徵，乙證3則揭
26 露系爭專利請求項3、4、7之技術特徵，系爭專利所載之先
27 前技術與乙證3或乙證1、3之組合，足以證明系爭專利請求
28 項3、4、7不具進步性；系爭專利所載之先前技術與乙證1、
29 2及如附表乙證4之組合，足以證明系爭專利請求項3、4不具
30 進步性；系爭專利所載之先前技術、乙證1至4之組合，足以
31 證明系爭專利請求項4不具進步性，系爭專利請求項1至4、7

01 即有得撤銷之事由，依智慧財產案件審理法第16條第2項規
02 定，原告不得據以對伊等主張權利。縱系爭產品落入系爭專
03 利請求項1至4、7之文義範圍，該等請求項且具進步性，依
04 系爭專利申請日前即100年6月7日惠特公司員工間寄送之電
05 子郵件所夾帶之檔案，揭示LEP6000覆晶檢測器，可配合白
06 膜/藍膜使用，以產生真空吸附白膜/藍膜達到固定待測晶片
07 之功效，已就製造此類機台及銷售完成必要之準備，依專利
08 法第59條第1項第3款前段規定，為系爭專利之專利權效力所
09 不及。因系爭產品未對系爭專利構成侵權，伊等製造、販賣
10 系爭產品無需原告同意或授權，非無法律上原因而受有利益
11 亦不符不法無因管理之要件，原告依專利法第96條第1
12 項、第2項、第97條第1項第2款、第2項、民法第177條第2
13 項、第179條、第184條第1項前段、第185條及公司法第23條
14 第2項規定，請求伊等排除侵害及連帶給付1,000萬元，均無
15 理由，並聲明：(一)原告之訴及假執行之聲請均駁回。(二)如受
16 不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

17 三、兩造不爭執事項(見本院卷一第315至317、323至325頁、卷
18 二第461至462頁，並依判決格式修正或刪減文句)：

19 (一)原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自103年3月21日起
20 至120年7月13日止。

21 (二)惠特公司主要業務如原證4經濟部商業司商工登記公示資料
22 查詢服務畫面所示。

23 (三)系爭產品為惠特公司所製造、為販賣之要約、販賣及使用之
24 產品。

25 (四)原證5為惠特公司針對系爭產品所發行之規格書。

26 (五)原證8為惠特公司109年年報節本。

27 (六)徐秋田自97年8月8日起擔任惠特公司之法定代理人。

28 (七)上開事實，並有兩造不爭執真正之中華民國專利公報(見本
29 院卷一第25至33頁)、中華民國專利證書(見本院卷一第35
30 頁)、發明說明書公告本(見本院卷一第37至59頁)、經濟部
31 商業司商工登記公示資料查詢服務(見本院卷一第61頁)、系

01 爭產品規格書(見本院卷一第63至73頁)、惠特公司109年年
02 報節本(見本院卷一第95至96頁)可稽，堪認屬實。

03 四、經本院於111年10月27日與兩造整理並協議簡化爭點為(見本
04 院卷一第461至462頁，並依本院論述與妥適調整文句)：

05 (一)系爭產品是否落入系爭專利請求項1至4、7之文義範圍？

06 (二)系爭專利請求項1至4、7是否具得撤銷之事由？

07 (三)原告依專利法第96條第1項規定請求被告不得直接或間接、
08 自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系
09 爭產品及其他侵害系爭專利之產品，有無理由？

10 (四)原告依專利法第96條第2項、民法第177條第2項、第179條、
11 第184條第1項前段、第185條及公司法第23條規定請求被告
12 連帶給付1,000萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日
13 止，按週年利率5%計算之利息，有無理由？

14 五、本院之判斷：

15 (一)系爭專利技術分析：

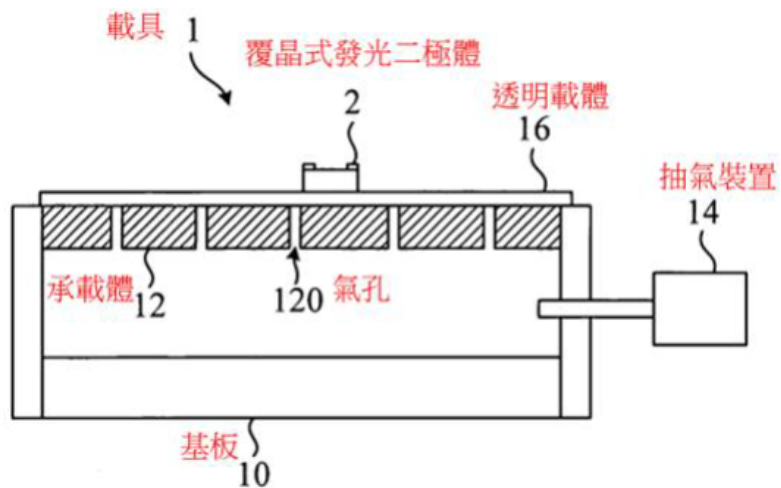
16 1.系爭專利技術內容：

17 發光二極體須通過測試才能為實際應用，因覆晶式發光二極
18 體之發光面與電極不在同一平面，不適用於現今水平式與垂
19 直式發光二極體之量測系統，而先前技術之覆晶式發光二極
20 體量測設備中承載體之氣孔會影響量測結果，消耗多餘之人
21 力物力，不利覆晶式發光二極體的發展。本發明揭露一種發
22 光二極體量測裝置，包含透明基板、間隔構件、軟性透明載
23 體及真空產生器。間隔構件係設置於透明基板之第一面上，
24 軟性透明載體可拆卸地接合於間隔構件之上，使得軟性透明
25 載體、間隔構件以及透明基板之第一面間形成密閉空間，真
26 空產生器可連接至密閉空間抽氣，使軟性透明載體部分平貼
27 於第一面上以形成用來承載覆晶式發光二極體之檢測區，可
28 更有效率地檢測覆晶式發光二極體的發光特性。

29 2.系爭專利主要圖式：

30 (1)圖一A係繪示先前技術之覆晶式發光二極體量測設備之載具
31 示意圖。

01

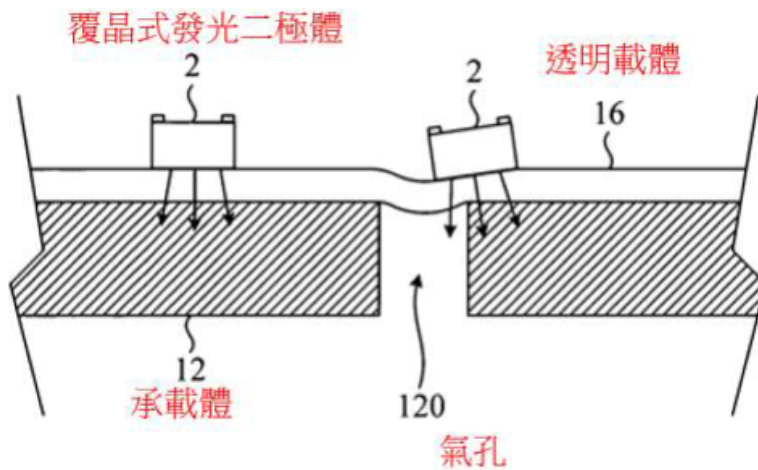


02

(2)圖一B係繪示圖一A之覆晶式發光二極體固定於承載體上之示意圖。

03

04

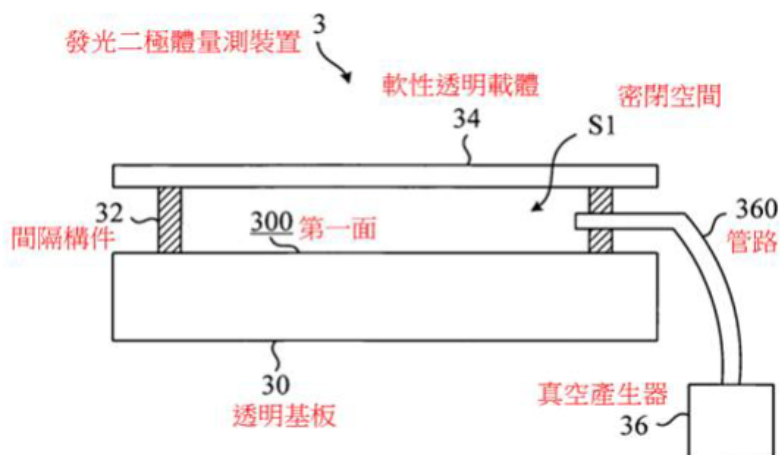


05

(3)圖二係繪示根據本發明之一具體實施例之發光二極體量測裝置的剖面示意圖。

06

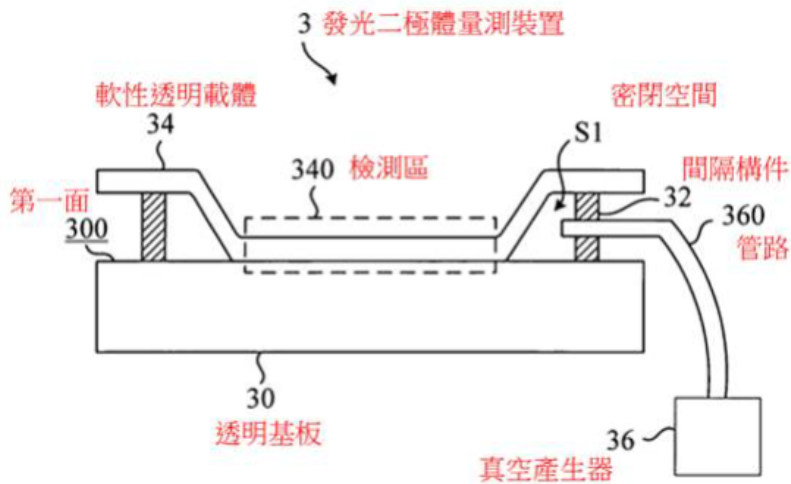
07



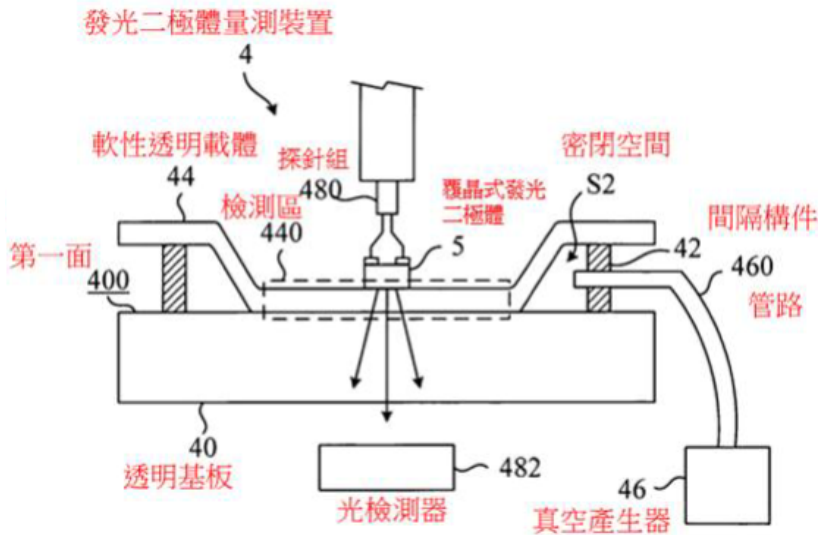
08

(4)圖三係繪示圖二之發光二極體量測裝置的真空產生器對密閉空間抽氣的剖面示意圖。

09



(5)圖四係繪示根據本發明之另一具體實施例之發光二極體量測裝置量測覆晶式發光二極體的剖面示意圖。



3.系爭專利申請專利範圍：

系爭專利請求項共7項，其中請求項1為獨立項，其餘請求項直接或間接依附於請求項1，原告主張請求項1至4、7受侵害，該等請求項內容如下：

(1)請求項1：

一種發光二極體量測裝置，用於量測一覆晶式發光二極體，該發光二極體量測裝置包含(下稱要件1A)：一透明基板，具有一第一面(下稱要件1B)；一間隔構件，設置於該第一面上(下稱要件1C)；一軟性透明載體，可拆卸地接合於該間隔構件上，其中當該軟性透明載體接合於間隔構件上時，該軟性透明載體、該間隔構件及該透明基板之該第一面之間形成一密閉空間；以及(下稱要件1D)一真空產生器，連接至該密閉

01 空間並用以對該密閉空間抽氣(下稱要件1E)；其中，當該透
02 明載體接合於該間隔構件上且該真空產生器對該密閉空間抽
03 氣時，該軟性透明載體部分平貼於該第一面上以形成一檢測
04 區，該檢測區係用以承載該覆晶式發光二極體(下稱要件1
05 F)。

06 (2)請求項2：

07 如申請專利範圍第1項所述之發光二極體量測裝置，進一步
08 包含一光檢測器，該光檢測器係用以接收自該透明基板而來
09 之光線。

10 (3)請求項3：

11 如申請專利範圍第2項所述之發光二極體量測裝置，進一步
12 包含一探針組，用以接觸承載於該檢測區上之該覆晶式發光
13 二極體的一P-N電極，以及對該P-N電極供給一檢測電源。

14 (4)請求項4：

15 如申請專利範圍第3項所述之發光二極體量測裝置，其中當
16 該探針組接觸承載於該檢測區上之該覆晶式發光二極體的該
17 P-N電極並供給該檢測電源時，該覆晶式發光二極體對應該
18 檢測電源而發光穿過該軟性透明載體之該檢測區以及該透明
19 基板。

20 (5)請求項7：

21 如申請專利範圍第1項所述之發光二極體量測裝置，其中該
22 真空產生器進一步包含一管路，並且該管路係穿過該透明基
23 板而與該密閉空間連接，該真空產生器係透過該管路對該密
24 閉空間抽氣。

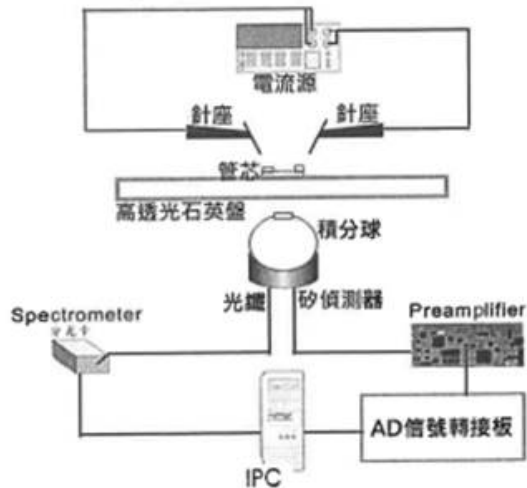
25 (二)系爭產品技術內容：

- 26 1.系爭產品係一覆晶型LED晶粒/晶圓點測機，其吸盤中心處為
27 透明之石英材質且周圍係金屬材質，當使用系爭產品進行測
28 試時，一擴張環可置於吸盤上表面，以乘載欲進行測試之晶
29 粒。擴張環上有一軟性透明薄膜，可拆卸地接合於擴張環之
30 橘色外框上。其外殼具有開啟吸盤真空功能之按鈕，當真空

產生器開始抽氣時，軟性透明載體會部分平貼於該第一面上以形成一檢測區。

2.系爭產品外觀與圖式：

(1)圖1係系爭產品測試機基本架構圖。

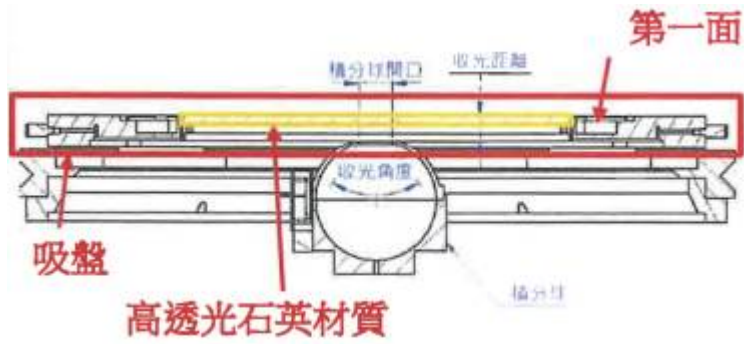


(2)圖2係系爭產品外觀。



(3)圖3係吸盤剖面圖。

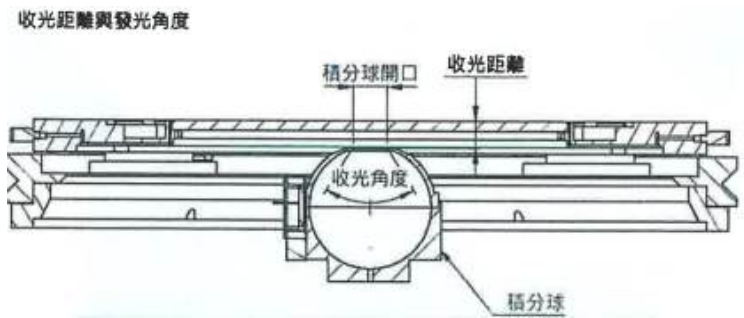
01



02

(4)圖4係收光距離與收光角度。

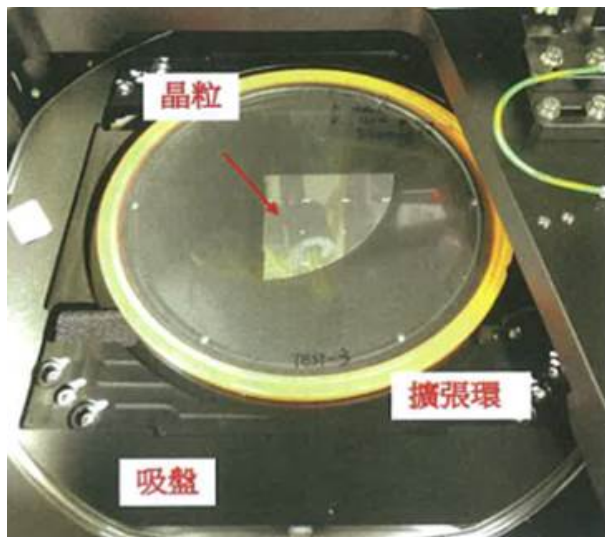
03



04

(5)圖5係擴張環上之一軟性透明薄膜。

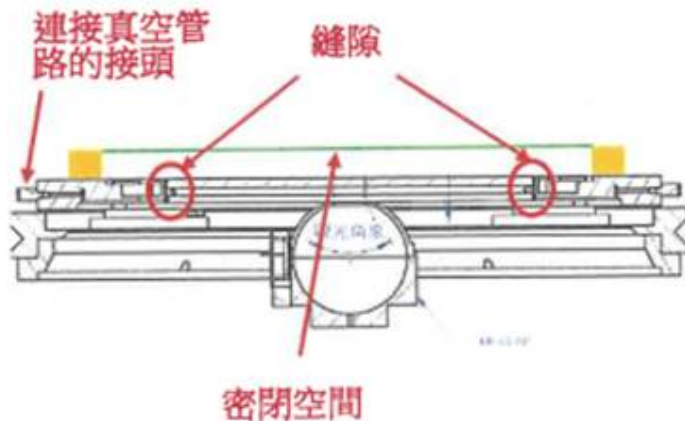
05



06



(6)圖6係真空產生器抽氣時，軟性透明載體部分平貼於該第一面上以形成一檢測區。



(三)系爭產品未落入系爭專利請求項1至4、7之文義範圍：

1.系爭專利請求項1部分：

(1)系爭專利請求項1之技術特徵可解析為如(一)3.(1)所示要件1A至1F。

(2)系爭專利請求項1與系爭產品技術特徵之要件比對：

①要件1A部分：

系爭產品規格書載明系爭產品係一覆晶型LED晶粒/晶圓點測機，可用於量測覆晶式發光二極體(見本院卷一第63至73頁)，完全對應於系爭專利請求項1要件1A，為該要件「一種發光二極體量測裝置，用於量測一覆晶式發光二極體，該發光二極體量測裝置包含」所文義讀取。

②要件1B部分：

①系爭產品之吸盤中心處為透明的石英材質且周圍係金屬材質，該吸盤對應於系爭專利請求項1之透明基板；吸盤之上表面對應於系爭專利請求項1之第一面，完全對應於系爭專利請求項1要件1B，為該要件「一透明基板，具有一第一面」所文義讀取。

②被告雖辯以系爭產品吸盤周圍係金屬材質而不透明，不應將金屬部分視為透明基板進行比對云云(見本院卷三第104頁)。惟依系爭專利說明書圖三，可清楚得知透明基板應於檢測區為透明，以進行檢測，而檢測區之外是否透明，與系爭專利之問題解決或功效無關，被告於本院審理時亦

表明不爭執透明膜下方是透明的等語(見本院卷三第162頁)，則吸盤中心處(檢測處)為透明之石英材質，自可對應於系爭專利請求項1之透明基板，被告所辯，難認可採。

③要件1C部分：

①原告主張使用系爭產品進行測試時，一擴張環(如圖5，其橘色外框對應於系爭專利請求項1之間隔構件)可置於吸盤之上表面，以承載欲進行測試之晶粒，為要件1C所文義讀取(見本院卷一第80至81、386頁)。被告則否認系爭產品有間隔構件。

②查系爭產品圖1測試機基本架構圖，未顯示有間隔構件。原告雖主張系爭產品圖5之擴張環橘色外框即為間隔構件，可與透明基板的第一面及透明載體形成一密閉空間(見本院卷一第81、386頁)，惟「間隔構件」與「擴張環」之文義明顯不同，而依原告陳稱：「為了在機台之間移動細小的半導體元件，可使用擴張環來裝載半導體元件以便於整批拿取」(見本院卷一第386頁)，參酌被告所辯：「擴張環是一個承載環，而不是做間隔…橘色的部分是用來讓薄膜可以撐開而已…」等語(見本院卷三第162頁)，可知擴張環應係供裝載待測物之用，非供作間隔之構件，加以系爭產品圖5之擴張環外框係置放在吸盤上表面之金屬材質處，非置放於透明基板之第一面上，而該置放處具有一定之剛性，二剛性元件之間亦難認可達到密閉功能，系爭產品應未落入要件1C「一間隔構件，設置於該第一面上」之文義讀取。

④要件1D部分：

①原告主張系爭產品擴張環上有一軟性透明薄膜，對應於系爭專利之軟性透明載體，可拆卸地接合於擴張環之橘色外框上(見本院卷一第81頁)。被告則否認系爭產品有軟性透明載體。

01 ②查系爭產品圖1測試機基本架構圖，未顯示有軟性透明載
02 體，難認系爭產品落入要件1D「一軟性透明載體，可拆卸
03 地接合於該間隔構件上，其中當該軟性透明載體接合於間
04 隔構件上時，該軟性透明載體、該間隔構件及該透明基板
05 之該第一面之間形成一密閉空間；以及」之文義讀取。

06 ③原告雖主張系爭專利請求項1所稱之「間隔構件」係對應
07 於系爭產品圖5之橘色擴張環外框；「軟性透明載體」係
08 對應於擴張環上之透明薄膜，該擴張環雖非系爭產品之附
09 屬部分，但為使用系爭產品時不可或缺之組件，惠特公司
10 之業務人員復未指定型號或規格，僅表明170-186mm之子
11 母環或212mm之disco frame都能在系爭產品使用，可見不
12 論塑膠環或disco frame均得輕易自市場上取得云云（見本
13 院卷一第386至387頁、卷三第177至178頁）。惟：

14 ①所謂「文義讀取」，係指被控侵權對象包含經解釋後的系
15 爭專利之請求項的每一技術特徵，亦即經解釋後的系爭專
16 利之請求項的每一技術特徵均出現(present)或存在(exis
17 t)於被控侵權對象中，則稱請求項「文義讀取」被控侵權
18 對象或被控侵權對象符合「文義讀取」，應判斷被控侵權
19 對象構成文義侵權。而「文義讀取」之判斷，應將解釋後
20 的系爭專利之請求項的每一技術特徵與被控侵權對象之對
21 應元件、成分、步驟或其間之關係等，分別進行比對，若
22 各別對應之技術特徵均相同，則被控侵權對象符合「文義
23 讀取」。反之，若被控侵權對象欠缺解釋後的系爭專利之
24 請求項的任一技術特徵，或有任一對應之技術特徵不相
25 同，則不符合「文義讀取」。

26 ②原告陳稱系爭專利請求項1之「間隔構件」、「軟性透明
27 載體」，均非系爭產品之附屬部分，可認系爭產品並無
28 「間隔構件」與「軟性透明載體」之技術特徵，應未落入
29 要件1D之文義讀取。

30 ③另觀諸系爭專利說明書第7頁末段至第8頁第2段載明「於
31 本具體實施例中，間隔構件32係設置於透明基板30的第一

面300之上，並將第一面300圍出一區域。軟性透明載體34可拆卸地接合於間隔構件32之上，當透明載體34接合至間隔構件32上時，可於兩者接合處施力使得兩者緊密接觸至無氣漏的程度，舉例而言，可於軟性透明載體34接觸間隔構件32之位置施予朝向間隔構件32之力，使得軟性透明載體34擠壓間隔構件32而形成緊密接觸。透明載體34緊密接觸間隔構件32可密封間隔構件32於第一面300上所圍出之區域，使得軟性透明載體34、間隔構件32以及第一面300之間形成密閉空間S1」、「真空產生器36具有一管路360穿過間隔構件32而連接至密閉空間S1，並且可藉管路360對密閉空間S1抽氣。由於軟性透明載體34與間隔構件32緊密接觸，使密閉空間S1呈無氣漏狀態，故對密閉空間S1抽氣可於其中產生負壓。軟性透明載體34具有可撓性，因此當密閉空間S1中呈現負壓時，軟性透明載體34之另一面會受到大氣壓力壓迫而形變，並朝向密閉空間S1中凹陷」等語(見本院卷一第45至46頁)，可知系爭專利發明主要目的係利用軟性透明載體與間隔構件緊密接觸，使密閉空間S1呈無氣漏狀態，對密閉空間S1抽氣可於其中產生負壓，其中央部分進一步地平貼在透明基板的第一面上而形成檢測區，該檢測區可用來承載覆晶式發光二極體，足見「間隔構件」及「軟性透明載體」屬系爭專利請求項1不可欠缺之主要技術特徵，系爭產品既無「間隔構件」及「軟性透明載體」之元件、構造，惠特公司之業務人員亦未表明塑膠環或disco frame可與系爭產品配合形成密閉空間，當無從認定系爭產品落入要件1D之技術特徵。

④從而，原告之主張，並無足採。

⑤要件1E部分：

①原告主張系爭產品外殼上具有開啟吸盤真空功能之按鈕，即具有真空產生器，其吸盤之石英材質與金屬材質間連接處未氣密，當真空產生器開始抽氣時，會透過石英材質與金屬材質間縫隙，對密閉空間抽氣(見本院卷一第83至84

頁)。被告則否認系爭產品有密閉空間。查系爭專利說明書第8頁第1段係載明：「…透明載體34緊密接觸間隔構件32可密封間隔構件32於第一面300上所圍出之區域，使得軟性透明載體34、間隔構件32以及第一面300之間形成密閉空間S1」（見本院卷一第46頁），而原告既表明吸盤之石英材質與金屬材質連接處非氣密而有縫隙，參酌系爭產品測試機基本架構圖確無間隔構件與軟性透明載體，可認系爭產品並無密閉空間，原告上開主張，難認可取。

②原告另主張當使用擴張環承載發光二極體晶粒並進行檢測時，透明膜係接合於擴張環的橘色外框及吸盤之上表面形成一密閉空間，符合「軟性透明載體，可拆卸地接合於該間隔構件上，其中當該軟性透明載體接合於間隔構件上時，該軟性透明載體、該間隔構件及該透明基板之該第一面之間形成一密閉空間」之技術特徵（見本院卷三第393頁）。然細核原告所提擴張環接合透明膜之照片顯示：外環顏色較深、內環上有透明膜故顏色較淺、外環下方露出透明膜等情狀（見本院卷三第392頁），可知該擴張環可區分成內環與外環，而內環與外環之組合，文義顯然無法落入系爭專利請求項1之「間隔構件」。又依系爭專利說明書第7頁末段至第8頁前段所載「當透明載體34接合至間隔構件32上時，可於兩者接合處施力使得兩者緊密接觸至無氣漏的程度」（見本院卷一第45至46頁），參酌系爭專利圖2至4，可見軟性透明載體應整個包覆並接合於間隔構件，而系爭產品之擴張環分成內環與外環且「外環下方露出透明膜」，透明膜並未包覆外環，亦不符合「該軟性透明載體接合於間隔構件上時，該軟性透明載體、該間隔構件及該透明基板之該第一面之間形成一密閉空間」之技術內容，原告之主張實不可採。

③從而，系爭產品未落入要件1E「一真空產生器，連接至該密閉空間並用以對該密閉空間抽氣」之文義讀取。

⑥要件1F部分：

原告主張系爭產品之真空產生器對密閉空間抽氣時，軟性透明載體部分平貼於第一面上以形成一檢測區(見本院卷一第85頁)，為被告否認，而原告已陳明系爭產品吸盤之石英材質與金屬材質連接處並非氣密(見本院卷一第84頁)，系爭產品復無間隔構件與軟性透明載體及密閉空間，可認系爭產品未落入要件1F「其中，當該透明載體接合於該間隔構件上且該真空產生器對該密閉空間抽氣時，該軟性透明載體部分平貼於該第一面上以形成一檢測區，該檢測區係用以承載該覆晶式發光二極體」之文義讀取。

(3)綜上，系爭產品並未落入系爭專利請求項1之文義範圍。

2.系爭專利請求項2至4、7部分：

系爭專利請求項2至4、7係直接或間接依附於請求項1，包含請求項1之技術特徵並再進一步界定，因系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍，系爭產品當然未落入系爭專利請求項2至4、7之文義範圍。

(四)依前所述，因系爭產品未落入系爭專利請求項1至4、7之文義範圍，不構成侵害專利權，故被告所提系爭產品不受系爭專利權效力所及，及系爭專利請求項1至4、7不具進步性之抗辯，即無再行判斷必要，附此敘明。

六、綜上所述，惠特公司生產、銷售之系爭產品並未落入系爭專利請求項1至4、7之文義範圍，不構成侵害原告之系爭專利權，惠特公司之負責人徐秋田自無侵害系爭專利權可言，其等製造、販賣系爭產品所得利益亦難認無法律上之原因，更不符不法無因管理之要件，則原告以被告侵害系爭專利權為由，依專利法第96條第1項規定，請求被告排除侵害，及依同法第96條第2頁、第97條第1項第2款、第2項、民法第177條第2項、第179條、第184條第1項前段、第185條、公司法第23條規定，請求被告連帶給付1,000萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，均無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所依附，應一併駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經
本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。又原告
既不得以系爭專利權遭侵害請求被告排除侵害或給付款項，
本件即無另為中間判決之必要，爰為終局判決，併此敘明。

八、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 1 月 6 日

智慧財產第四庭

法 官 林昌義

以上正本證明與原本無異。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日不變期間內向本院提出上
訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 112 年 1 月 6 日

書記官 張禎庭

附表

編 號	內 容	公開/公告日
乙證1	日本昭第62-174608A號「圖 案檢測裝置」專利案	1987年7月31日
乙證2	日本特開第2000-164535A號 「鐳射加工裝置」專利案	2000年6月16日
乙證3	日本特開第2007-19237A號 「雙面發光元件探測器」專 利案	2007年1月25日
乙證4	美國公告之第US6384612B2號 「用於檢測發光裝置之光輸 出的方法及裝置」專利	2002年5月7日
乙證6	大陸公告之第CZ000000000Y 號「基板貼合裝置」專利。	2008年12月10 日
上開證據公開或公告日皆早於系爭專利申請日2011年7月1 4日		
